

安徽芯动联科微系统股份有限公司

公司代码:688582 公司简称:芯动联科

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细披露了可能面对的风险,提请投资者注意阅读。

3.本年度报告涉及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是否√否

7.董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.48元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本为401,739,056.00股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币59,457,380.29元(含税)。本年度现金分红(包括2025年下半年度已分配的金红利)总额为121,969,023.25元(含税),金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为40.20%。

公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

□是否√不适用

□适用√不适用

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 基本情况

1.公司简介

1.1.公司股票情况

√适用□不适用

股票简称	股票代码	上市交易所	行业	经营范围	变更情况
芯动联科	688582	上海证券交易所科创板	软件和信息技术服务业	微系统	无

1.2.公司存在担保情况

□适用√不适用

1.3.联系人和联系方式

姓名	职务	联系地址	电话	电子邮箱
林柯	董事长	北京市海淀区知春路7号真人大厦A座19层1901号	010-83030889	linke@cnmems.com
李强	总经理	北京市海淀区知春路7号真人大厦A座19层1901号	010-83030889	liqiang@cnmems.com
李强	财务总监	北京市海淀区知春路7号真人大厦A座19层1901号	010-83030889	liqiang@cnmems.com
李强	董事会秘书	北京市海淀区知春路7号真人大厦A座19层1901号	010-83030889	liqiang@cnmems.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1.主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售。公司主要产品为高性能MEMS惯性传感器,包括MEMS陀螺仪和MEMS加速度计,均包含一颗微陀螺仪(MEMS)芯片和一颗微加速度计芯片。MEMS陀螺仪和MEMS加速度计通过自身惯性运动状态和运动速度的感知,是惯性传感器的核心器件,高性能微陀螺仪和微加速度计是惯性传感器的核心器件。硅基MEMS惯性传感器因小型化、高集成、低成本的优势,成为现代惯性传感器的重要发展方向。

公司已形成自主知识产权的高性能MEMS惯性传感器主要系批量生产及应用,在MEMS惯性传感器设计、MEMS工艺开发、封装与测试等主要环节构建了技术闭环,建立了完整的业务流程和供应链体系。公司高性能MEMS惯性传感器通过下游模组和系统厂商的开发与集成,主要用于高端工业、石油勘探、测绘、无人系统、高可靠等领域,并广泛应用于航空航天领域的终端产品,为用军实现精准定位、姿态感知、环境监测、平台稳定等多重应用功能。不同于其他MEMS惯性传感器主要应用的消费电子领域,高端工业、石油勘探、测绘、无人系统、高可靠等领域对精度、稳定性要求更高,而公司的产品核心性能与国际高性能MEMS惯性传感器龙头对标。

目前,高性能MEMS陀螺仪的精度可达到中低精度的微光陀螺仪和光纤陀螺仪,随着MEMS技术的发展和成熟,MEMS惯性传感器在保持原有低成本、小体积、可批量生产等优势下,精度水平与高端传统陀螺仪相当,并可在多种复杂应用场景实现陀螺仪和陀螺仪,并逐步渗透至高精度应用场景。高性能MEMS加速度计接近石英加速计水平,可达到导航级水平。MEMS惯性技术作为惯性传感器领域的核心技术之一,将在自动驾驶、高端工业等领域覆盖更多的应用场景,市场前景较为广阔。

报告期内,公司持续进行产品迭代,客户数量持续增长,下游应用领域持续开拓。

2.2.主要经营模式

公司采用行业常用的Fabless经营模式,专注于MEMS惯性传感器芯片的研发、测试和销售,晶圆制造环节由专业的晶圆制造厂商完成,芯片封装环节由封装厂/自有封装产线生产,在取得芯片成品并完成测试后对外销售。

1.研发模式

(1)产品设计及研发

Fabless经营模式下,产品设计研发属于公司的核心环节,涉及到市场营销部、研发部、生产部、质量部等部门协同合作。公司建立了产品、生产和质量三大流程,并构建了产品、生产和质量三大流程,将产品流程分为概念、计划、开发、验证、试生产和量产六个阶段。

(2)MEMS工艺开发流程

公司MEMS芯片采用的MEMS体加工工具有标准化的特点,MEMS晶圆代工厂只提供晶圆工艺模块,公司需要根据自身MEMS芯片设计的特点开发与之匹配的MEMS工艺方案,并导入晶圆代工厂,以达到批量生产目的。

2.采购模式

公司不直接从事芯片的生产加工,主要采购MEMS晶圆、ASIC晶圆及封装服务等。报告期内,公司的主要供应商为安徽北方微电子研究院集团有限公司、ERA、上海华光电子科技有限公司等。

公司将采购的芯片交付晶圆代工厂进行晶圆加工,之后由封装厂/自有封装产线进行封装,再由公司进行产品测试与封装。

(3)采购流程

在晶圆生产环节,公司与晶圆代工厂签订框架协议,并根据市场需求下达订单,晶圆代工厂根据订单后批量生产。MEMS晶圆的生产周期通常为9-12个月,ASIC晶圆的生产周期通常为3-6个月左右。由于晶圆采购周期较长,公司需要根据市场情况进行一定量的备货,晶圆采购完成后,经测试合格后,公司向相应的封装厂/自有封装产线下达订单生产,封装完成后的芯片发送给公司,公司验收后,完成芯片入库。

(4)供应商的选择

公司所处的芯片行业高度全球化,产业链高度分工化,相关地区、地区的头部厂商建立了多年的积累的技术和市场地位,充分利用其比较优势,在芯片产业链细分行业上分别建立了较高的技术和市场壁垒,逐步演变成了目前全球市场格局。在确保供应同时,公司主要从供应商的技术工艺水平、生产模式、生产时间、加工成本、产品质量、产能水平、供货及时性、历史生产情况等多方面综合评估,严格控制晶圆代工和封装过程中的风险。

3.生产模式

市场销售每年编制下一年度的销售计划,每月滚动更新未来六个月的销量预测,生产运营根据销售需求计划下达采购订单,委托晶圆代工厂/封装厂/自有封装产线按照排产计划进行生产,最后由公司将对封装芯片进行测试和验收入库。

4.销售模式

公司目前采取直销和经销相结合的模式进行产品销售。直销模式下,客户直接向公司下单,签订销售合同,公司根据客户订单进行生产销售;经销模式下,经销商根据其渠道客户需求向公司下达订单,签订销售合同,公司根据订单进行生产和销售。

2.3.所处行业情况

(1).行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售。根据中华人民共和国国家统计局发布的《国民经济行业分类(CB/T4754-2017)》,公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)中的“敏感元件及传感器制造”(C3983)。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司属于战略性新兴产业之“新一代信息技术产业”(代码1.1)项下的“电子核心产业”(代码1.2)中的“新型电子元器件及高端制造”(代码1.2.1);根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司属于“新一代信息技术产业”(代码:1)项下的“电子核心产业”(代码:1.3)项下的“新型元器件”(代码:1.3.3)中的“新型传感器”。

(2).行业发展阶段

MEMS微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System),是利用大规模集成电路制造技术和微加工技术,把微传感器、微执行机构、微结构、信号处理与控制电路、电源以及通信接口等集成在一块或多片芯片上的微型器件或系统。MEMS器件种类众多,主要分为MEMS传感器和MEMS执行器。MEMS传感器可以感知和测量物体的特定状态和变化,并按一定规律将被测量的状态和变化转换为电信号或者其它可用信号,MEMS执行器则将控制信号转换为微小机械运动或机械操作。

最早的陀螺仪基于牛顿经典力学原理,利用高速旋转的陀螺转子来测量计算运动载体的旋转角速率。经历一百多年的漫长发展,人们又研制出了多种基于不同测量原理具有不同测量精度的陀螺仪,按不同测量原理和发明先后,惯性技术发展通常分为四代,MEMS陀螺仪是第三代陀螺仪的代表。

第一代,基于牛顿经典力学原理。典型代表为机电陀螺仪(及动力调谐陀螺仪,其特点是种类多、精度高、体积质量大、系统集成结构复杂,性能受机械结构复杂性和极限精度制约,产品制造维护成本高昂。

第二代,基于谐振壳效应。典型代表是激光陀螺仪和光纤陀螺仪,其特点是反应时间短、动态范围大、环境适应性强、易维护、寿命长。光学陀螺仪技术较为成熟,精度高,随着产品迭代,光学陀螺仪及其系统应用从航空航天逐步拓展到自动驾驶应用,在陆、海、空、天等多个领域中广泛推广应用,但由于其成本大、体积大,应用受到一定程度限制。

第三代,基于谐振壳效应和微加工技术。典型代表是半球谐振陀螺仪和MEMS陀螺仪。半球谐振陀螺仪是微型化陀螺仪中的一种高精度陀螺仪,正逐步在空间、航空、航海等领域开展应用,但受限于结构及制造技术,市场上可规模化生产的企业较少。MEMS陀螺仪具有体积小、重量轻、环境适应性强、价格低、易于大批量生产等特点,率先在消费电子领域得到推广应用,随着性能持续提升,高端MEMS陀螺仪应用也被拓展到了工业、航空航天等领域,惯性传感器应用领域大为扩展。

第四代,基于现代量子力学技术。典型代表为磁光陀螺仪、原子干涉陀螺仪。其目标是实现高精度、高可靠、小型化和更广泛应用领域的导航系统,目前仍处于早期研究阶段。

MEMS陀螺仪具有小型化、高集成、低成本的优势,解决了第一代、二代陀螺仪体积质量大、成本不足,并随着精度和稳定性的持续提升,在陀螺仪市场中占据了重要的位置。

综上所述,由于不同技术路线的陀螺仪可实现类似的功能,因此MEMS陀螺仪和激光陀螺仪、光纤陀螺仪在部分军民人系统、高端工业、高可靠等应用领域有所重合。随着高性能MEMS陀螺仪的精度不断提升,并可逐步应用于中低精度激光陀螺仪、光纤陀螺仪的应用领域。同时,由于高性能MEMS陀螺仪具有体积小、高集成、抗高过电压的优势,可以解决光纤陀螺仪和激光陀螺仪由于体积较大、抗冲击能力弱的问题,满足高可靠、无人系统等领域智能化升级的要求,进一步拓展高性能MEMS陀螺仪的增量市场。

(3).行业基本特点

MEMS惯性传感器行业是多学科融合的高新技术领域,涉及物理、信息技术、机械、电子学、半导体材料等多门学科,学科交叉深度高,技术复杂程度高,工艺难度大。高性能MEMS惯性传感器要做到稳定量产,需要在MEMS芯片设计及工艺方案、ASIC芯片设计、封装、测试各个环节均具备相应的技术能力并建立完善的技术体系和工艺方案,技术壁垒高。

(4).行业主要技术门槛

多学科融合的综合运用

MEMS是一门交叉学科,MEMS产品的研发与设计涉及物理、信息技术、机械、电子学、半导体材料等多门学科。对研发人员的专业知识的技术储备和对上下游行业理解能力都提出了非常高的要求。

各生产环节均存在技术壁垒

MEMS惯性传感器的研发步骤更加复杂,不仅涵盖了MEMS芯片设计及工艺方案,还包括了ASIC芯片的设计,公司MEMS芯片采用的MEMS体加工工艺具有非标准化的特点,MEMS晶圆代工厂只是提供基础工艺模块,公司需要根据自身MEMS芯片设计的特点开发与之匹配的MEMS工艺方案,并导入晶圆代工厂。公司需要投入MEMS芯片设计及工艺方案、ASIC芯片设计、算法、封装、测试等各个环节均具备相应的技术能力并建立完善的技术体系和工艺方案。

(5).公司所处的行业地位及其变化情况

公司是国内较早从事高性能MEMS惯性传感器研发的芯片设计公司,掌握高性能MEMS惯性传感器核心技术,是目前极少数可以实现国内高性能MEMS惯性传感器稳定量产的国内企业。公司产品MEMS陀螺仪及加速度计的精度在国内高性能MEMS惯性传感器行业内处于领先地位。

公司所处细分行业为高性能MEMS惯性传感器行业,惯性传感器按照性能不同大致可划分为战略级、导航级、战术级/工业级/消费级等不同级别,公司目前的主要产品覆盖导航级至工业级的性能区间,不同于其他消费级MEMS惯性传感器主要应用于消费电子领域,高性能MEMS惯性传感器主要适用于高端工业、无人系统、高可靠等应用领域。随着公司MEMS惯性传感器性能及环境适应性不断提升,叠加自主可控与国产替代需求日益迫切,公司产品下游应用领域持续开拓,行业地位进一步提升。

报告期内公司下游应用领域发展情况

高端工业领域:高端工业领域主要是指航空航天、测绘、测绘、工业物联网等,对惯性传感器能够在高、多变的长时间保持高精度感知并传递外部环境变化的要求高,对惯性传感器的稳定性、抗冲击性和抗冲击性等方面要求更高,因此MEMS传感器相对于其他方面优势符合高端工业领域的需求。以测量导航市场为例,根据全球基础设施中心预测,2024年至2040年全球基础设施投资存在11.1亿美元缺口,其中,东南亚、非洲、拉美等地区基础设施水平落后,基础设施投资空间较大,有望持续拉动测绘仪器的需求,尤其国产测绘仪器带来高成长机会。根据国际工业内销售情况看,融合惯性传感器的国产RTK接收机可实现高精度、更高效率的测量,并产品在海外市场保持较高增长。由于公司的MEMS惯性器件在满足性能的同时兼具低成本的特点,际际在高端工业领域有望逐步实现国产替代并获得海外市场的认可。

无人系统领域:无人系统包含无人机、无人车、无人艇、无人潜航器等以及机器人等多种无人平台,不同利用惯性传感器及捷联惯性导航系统,可以为无人系统提供精确的位置、姿态和姿态信息,具体表现在卫星信号较弱甚至丢失的情况下,根据惯导测量单元实现测量的加速度和角速率信息,继续利用惯性导航以推算出最新的位置,在短时间内容仍可以得到较高精度

的位置信息,利用航迹推算实现短程导航,大大提高安全性,因此MEMS IMU已成为无人系统中不可缺少的关键器件。报告期内,政策鼓励低空经济、自动驾驶发展,下游厂商积极推进行,为公司MEMS惯性传感器提供更高、更广泛的应用机会:

1.低空经济:低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射带动相关经济形态,根据通用航空装备创新发展应用战略(2024-2030年),2030年低空经济将带动万亿市场规模。当前,低空经济发展战略已逐步落实到组织和各地方面;2024年12月,国家发展改革委部署低空经济发展司成立,负责指导并组织实施低空经济发展战略,中长期发展目标:2025年1月,各地纷纷召开会议,共有30个省市区在2026年生产取证,2027年完成适航取证,而飞控及运动姿态是保障飞行安全的重要基础,高性能MEMS惯性传感器是其能够实时感知低空经济的运动姿态、监测航姿姿态变化的核心零部件,随着当前行业趋势,需求有望增加。

2)自动驾驶:国家对“车路云一体化”的布局以及自动驾驶相关条例的意见征求表明智能驾驶、无人驾驶的商用智能化要求不断提高,商用落地加快,带动上游MEMS IMU的规模化机会。报告期内,(关于开展智能网联汽车车路云一体化应用试点的通知)围绕建设智能化路侧感知设施,提升车路协同感知能力等方面,开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。目前,进行L4级自动驾驶测试的全面落地多,部分进展较快的车企将很快推出L3级别的自动驾驶车辆,而自动驾驶对于MEMS IMU的性能要求也会更高,将有利于在高性能MEMS惯性器件具备优势的公司同步获得增量。

高可靠领域:高可靠领域主要是指商业航天、商业航海等,其对于惯性传感器的精度要求较高,是高性能MEMS惯性传感器的重要应用领域,根据Yole Intelligence预计,2029年高性能MEMS惯性传感器在全球高可靠领域的市场规模可达40.73亿美元。尤其是在商业航天领域,随着国内可重复利用火箭测试取得突破性突破,商业航天运力也在爆发增长,包括互联网发射及空天算力方面的行业将爆发式增长,市场前景巨大。根据公开资料,“星网GW”于2026年1月,连续两次完成“前九星”发射,将抵轨卫星星座数量总计提升至154颗,并最终以完成1292颗的卫星星座计划。“G60”帆星组网也已达到了108颗卫星在轨组网,并计划最终部署超1.5万颗卫星。根据中国星网“G60”帆星组网以及鸿路-3的发射计划,未来发射需求属于万颗级别。由于每颗卫星需要搭载2-3套惯性模组,公司的MEMS惯性器件在高性能的同时兼具小型化的优势,更契合下游发展需求,同时,公司产品在商业航天领域已经有所应用并具备多年、具备较大的先发优势。

随着国内公司向自动驾驶及CMOS工艺及L4级无人物流车客户提供MEMS惯性模组;向低空经济领域客户提供技术方案,测试方案并进行质量控制体系认证,积极融合应用于飞行器的航迹认证过程,通过投入研发力量为低空经济提供高性能MEMS惯性传感器并配合适航认证的供应商;公司也向商业航天配套企业提供MEMS惯性器件及模组,是自主可控MEMS惯性传感器的主要供应商之一。

(3).报告期新技术、新产业、新业态、新商业模式的发展情况和未来发展趋势

(1)MEMS行业发展的更精准可靠的传感器

各智能设备对于信息获取和交互的关键部件,对传感器收集数据的丰富程度和精确程度要求越来越高。对于可以感知运动、自主决策的无人系统,准确的感知能力和高精度定位能力至关重要。MEMS传感器精度提升有助于将应用场景扩展至高精度领域。同时,MEMS惯性传感器的应用范围越来越广,泛行业内公司需要采用新技术、新工艺使MEMS惯性传感器在复杂的环境中保持精准可靠。

(2)MEMS传感器微型化、集成化的发展趋势

随着MEMS工艺及CMOS工艺和MEMS工艺集成,MEMS传感器可以在更小面积的芯片上集成更多的运算与存储能力,更好地满足系统应用对低成本、小体积、高可靠等各个领域,满足不同应用场景的需求。同时,随着5G通信技术的发展,计算技术的高速迭代和物联网节点的不断增长,对于传感器数量和数据精度的要求将进一步提升。未来,工业物联网、车联网、智能城市、智能家居等新兴产业都将为MEMS传感器行业打开应用空间,尤其自动驾驶汽车需要多种高精度、高可靠性的传感器,将创造巨大的行业空间,引领MEMS传感器的下一代应用浪潮。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1.近三年主要会计数据和财务指标

	2025年	2024年	本报告期末比上年末增减(%)	币种:人民币
营业收入	299,894.02	266,288.58	12.56	277,472.02
归属于上市公司股东的净利润	20,279.15	25,349.89	-1.96	21,334.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,579.87	48,268.28	-31.88	38,968.88
经营活动产生的现金流量净额	39,282.84	22,271.34	76.36	34,938.88
归属于上市公司股东的净资产	384,104.08	327,314.12	14.58	343,839.00
归属于上市公司股东的每股净资产	29.87	21.77	37.16	24.06
归属于上市公司股东的净资产占期末总资产的比例	33.04	31.23	0.76	34.06
归属于上市公司股东的总资产	114,914.08	105,164.08	9.31	110,263.11
归属于上市公司股东的总资产占期末总资产的比例	29.37	29.67	-0.10	34.06
归属于上市公司股东的总资产占期末总资产的比例	12.84	10.11	26.92	12.66
归属于上市公司股东的总资产占期末总资产的比例	6.75	6.85	-0.10	36.36
归属于上市公司股东的总资产占期末总资产的比例	25.44	27.07	-6.63	34.06

3.2.报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3个月)	第二季度(4-6个月)	第三季度(7-9个月)	第四季度(10-12个月)	币种:人民币
营业收入	4,799.22	16,824.14	4,789.87	12,276.79	
归属于上市公司股东的净利润	4,436.77	10,995.98	4,844.58	6,462.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,985.65	10,796.03	4,719.06	6,444.77	
经营活动产生的现金流量净额	3,525.84	16,824.14	4,789.87	7,622.11	

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4.1.普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

	单位:股
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,647
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	24,874
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,647
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	24,874
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,647
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	24,874

前10名普通股股东持股情况(单位:股)

序号	名称	持有股份数量	持股比例	限售	质押、冻结或司法冻结	股东类型
1	MEMSLINK Corporation	80,000,000	20.11%	80,000,000	0	境外法人
2	上海芯动联科微系统股份有限公司	55,996,422	14.44%	0	0	境内法人
3	北京芯动联科微系统股份有限公司	53,700,000	14.12%	53,700,000	0	境内法人
4	北京芯动联科微系统股份有限公司	15,500,000	4.11%	15,500,000	0	境内法人
5	北京芯动联科微系统股份有限公司	14,900,000	3.72%	14,900,000	0	境内法人
6	北京芯动联科微系统股份有限公司	7,700,226	1.97%	7,700,226	0	境内法人
7	北京芯动联科微系统股份有限公司	5,200,000	1.31%	5,200,000	0	境内法人
8	北京芯动联科微系统股份有限公司	4,800,000	1.20%	4,800,000	0	境内法人
9	北京芯动联科微系统股份有限公司	4,740,000	1.14%	4,740,000	0	境内法人
10	北京芯动联科微系统股份有限公司	4,300,000	1.14%	4,300,000	0	境内法人

注:MEMSLINK Corporation,为境外法人,注册地:开曼群岛,通过香港一家全资子公司持有本公司股份,持有本公司股份总数为80,000,000股,占本公司股份总数的20.11%。上海芯动联科微系统股份有限公司,为境内法人,注册地:上海,通过全资子公司持有本公司股份,持有本公司股份总数为55,996,422股,占本公司股份总数的14.44%。北京芯动联科微系统股份有限公司,为境内法人,注册地:北京,通过全资子公司持有本公司股份,持有本公司股份总数为53,700,000股,占本公司股份总数的14.12%。北京芯动联科微系统股份有限公司,为境内法人,注册地:北京,通过全资子公司持有本公司股份,持有本公司股份总数为15,500,000股,占本公司股份总数的4.11%。北京芯动联科微系统股份有限公司,为境内法人,注册地:北京,通过全资子公司持有本公司股份,持有本公司股份总数为14,900,000股,占本公司股份总数的3.72%。北京芯动联科微系统股份有限公司,为境内法人,注册地:北京,通过全资子公司持有本公司股份,持有本公司股份总数为7,700,226股,占本公司股份总数的1.97%。北京芯动联科微系统股份有限公司,为境内法人,注册地:北京,通过全资子公司持有本公司股份,持有本公司股份总数为5,200,000股,占本公司股份总数的1.31%。北京芯动联科微系统股份有限公司,为境内法人,注册地:北京,通过全资子公司持有本公司股份,持有本公司股份总数为4,800,000股,占本公司股份总数的1.20%。北京芯动联科微系统股份有限公司,为境内法人,注册地:北京,通过全资子公司持有本公司股份,持有本公司股份总数为4,740,000股,占本公司股份总数的1.14%。北京芯动联科微系统股份有限公司,为境内法人,注册地:北京,通过全资子公司持有本公司股份,持有本公司股份总数为4,300,000股,占本公司股份总数的1.14%。

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权恢复前十名股东持股情况

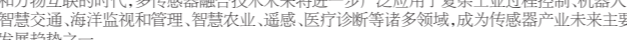
□适用√不适用

4.2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4.报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5.公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的不适用。

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2026-012

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次和届次

2025年年度股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 会议时间:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和地点

召开日期:2026年4月15日 14:00分

召开地点:北京·北京市海淀区知春路7号真人大厦A座19层1901号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月15日

至2026年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	C2025年年度报告(含摘要)	√
2	C《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3	C《关于2025年度募集资金使用情况的专项报告》	√
4	C《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	C《关于续聘会计师事务所的议案》	√

注:本次股东大会还将分别听取《2025年度独立董事述职报告》(高级管理人员 2026年度薪酬方案)

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已在第二届董事会第十六次会议审议通过,相关公告已于2026年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2025年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载《安徽芯动联科微系统股份有限公司2025年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案

3.对中小投资者单独计票的议案:2.3.4.5

4.涉及关联股东回避表决的议案:3.4

5.应回避表决的关联交易议案:3.4

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证及交易系统认证,并绑定手机号码和开通条件。3.4

(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票的表决意见。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议登记办法

(一)登记时间:2026年4月14日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:00);(二)登记地点:安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会办公室(北京市海淀区知春路7号真人大厦A座19层1901号);

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间和地点现场办理登记,单独股东可通过信函、传真、邮件等方式办理,以抵达时间为准。信函上请注明“股东”字样,公司不接受电话登记。

(四)自然人股东:本人有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)或持股证明;(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件(经本人股票账户卡授权)或持股证明;

(3)法人股东(法定代表人)执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股票账户卡(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证复印件原件、股票账户卡原件(如有)或持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股票账户卡(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证复印件原件、授权委托书原件(经本人股票账户卡授权)或持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向该券商出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效身份证件;投资者为机构的,应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有有效证件均带一份复印件,如通过信函、传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后作为登记凭证。

一、其他事项

(一)本次股东大会半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证原件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便现场入场。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区知春路7号真人大厦A座19层1901号董事会办公室

邮政编码:100083

联系电话:010-83030889

联系电话:010-83030886

邮箱:cnmems@cnmems.com

联系人:林柯;张秋月

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2026年3月24日

2026年度,授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组级别的级别、投入时间和工作质量